(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
28. April 2011 (28.04.2011)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2011/047894 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/677 (2006.01) *H01L 31/18* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2010/060985

(22) Internationales Anmeldedatum:
28. Juli 2010 (28.07.2010)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2009 050 845.7
19. Oktober 2009 (19.10.2009) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **GEBR. SCHMID GMBH & CO.** [DE/DE]; Robert-Bosch-Straße 32 - 34, 72250 Freudenstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **SCHMID, Christian** [DE/DE]; Zeppelinstr. 18, 72250 Freudenstadt (DE).

(74) Anwalt: **RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER**; Postfach 10 40 36, 70035 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR TREATING A SUBSTRATE SURFACE OF A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung : VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG EINER SUBSTRATOBERFLÄCHE EINES SUBSTRATS

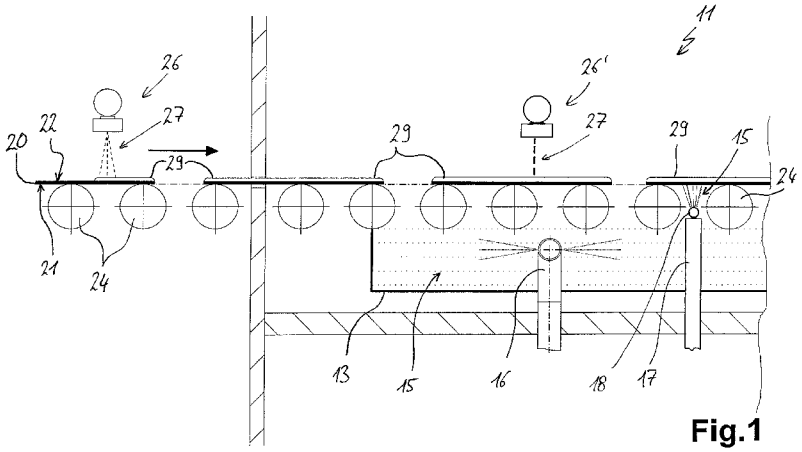


Fig.1

(57) Abstract: In a method for treating a substrate surface of a flat substrate with a process medium on the lower side of the substrate, the process medium has a removing or etching effect on the substrate surface. The substrates are wetted from beneath with the process medium while lying horizontally. The upwardly directed upper side of the substrate is wetted or covered over a large surface area or completely with water or a corresponding protective liquid as protection against the action of the process medium on the upper side of the substrate.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Behandlung einer Substratoberfläche eines flachen Substrats mit einem Prozessmedium an der Substratunterseite weist das Prozessmedium eine abtragende bzw. ätzende Wirkung auf die Substratoberfläche auf. Die Substrate werden horizontal liegend von unten mit dem Prozessmedium benetzt. Die nach oben weisende Substratoberseite wird mit Wasser oder einer entsprechenden Schutzflüssigkeit großflächig bzw. vollflächig benetzt oder bedeckt als Schutz gegen Einwirken des Prozessmediums auf die Substratoberseite.

WO 2011/047894 A1